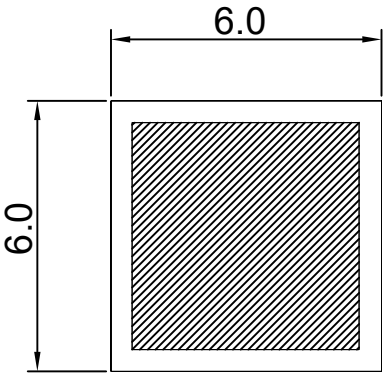
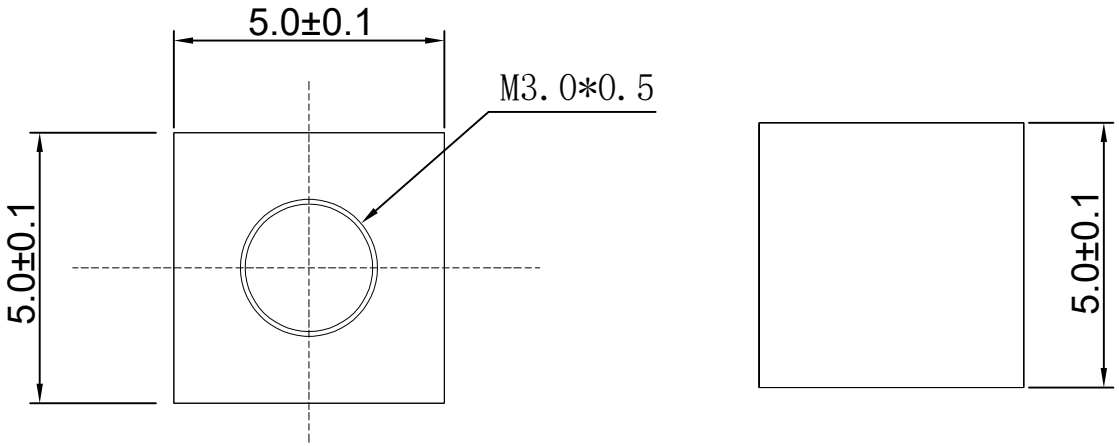
RoHS

REV	ECN NO.	DESRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2026.05.08

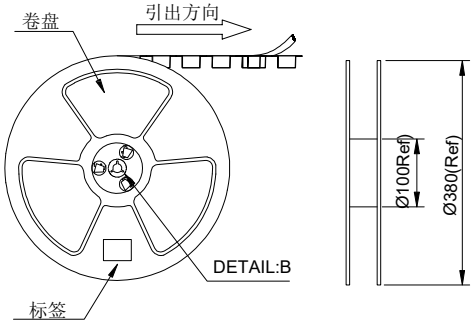


PCB LAYOUT

技术要求：
1.打铜底0.5-1μm,镍2-2.5μm，镀雾锡3-5μm。
2.铆好后不得有松动现象。
3.插脚尖部符合可焊性要求。
4.螺纹需符合通止规/止针要求。
5.螺纹扭矩：0.6Nm.
6.额定电流 ：30A.



载带图



包装说明：
1.把成品贴麦拉包入卷盘中，每盘装1000PCS,卷盘上贴标签

序号	名称	零件编号	材质	数量
1	插脚		H62(Y2)	1

＞30.±0.4	X.°±
6-30±0.3	.X°±
0-6±0.2	.XX°±
ANGLES±1°	.XXX°±
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

PART NO:	TS30000-R		**XFCN** 兴飞连接器	
TITLE:	PCB SOLDERING TERMINAL		0769-82001899	
			www.xfconn.com	
			DWG NO: /	
APPD	Chen ZhiQiang			
CHKD	Liu Wei	VIEW		
DRAW	Chen HongJiang	SCALE	SHEET	REV
DATE	2026.05.08	NONE	1/1	A1